

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第4区分

【発行日】平成20年3月6日(2008.3.6)

【公開番号】特開2002-230747(P2002-230747A)

【公開日】平成14年8月16日(2002.8.16)

【出願番号】特願2001-23420(P2001-23420)

【国際特許分類】

G 1 1 B	5/84	(2006.01)
B 2 2 F	5/00	(2006.01)
C 0 3 B	11/00	(2006.01)
C 0 3 B	11/08	(2006.01)
C 2 2 C	1/05	(2006.01)
C 2 2 C	29/08	(2006.01)

【F I】

G 1 1 B	5/84	Z
B 2 2 F	5/00	F
C 0 3 B	11/00	M
C 0 3 B	11/00	A
C 0 3 B	11/08	
C 2 2 C	1/05	H
C 2 2 C	29/08	

【手続補正書】

【提出日】平成20年1月17日(2008.1.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】バインダー成分の含有量を12重量%以下にし、金型母材の20～400
0の温度範囲における熱膨張係数を6×10⁻⁶/以下にした、

ことを特徴とするハードディスクガラス基板成形用金型。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するため、本発明のハードディスクガラス基板の成形用金型では、バインダー成分の含有量を12重量%以下にし、金型母材の20～400
の温度範囲における熱膨張係数を6×10⁻⁶/以下にしている。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

【発明の実施の形態】

本発明の請求項1に記載の発明は、ハードディスクガラス基板成形用金型において、バインダー成分の含有量を12重量パーセント以下にし、金型母材の20～400の温度範囲における熱膨張係数を $6 \times 10^{-6}/$ 以下にしている。これにより、高耐熱性と高強度、高熱伝導性を確保しながら、全面に渡ってうねりのない超平滑面をもつハードディスクガラス基板用金型を得ることが出来る。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】削除

【補正の内容】